

供媒體即時發佈

投資者關係：

Ed Lockwood

投資者關係資深總監

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係：

Meggan Powers

企業宣傳資深總監

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor 推出 Archer™ 300 LCM 疊對測量系統

高效能-低擁有成本之設計，支援線上及時監測與曝光機檢驗應用，瞄準 1Xnm 半間距記憶體和 2Xnm 邏輯處理技術

【加州 MILPITAS 2010 年 6 月 22 日訊】今天，專為半導體和相關產業提供製程控制與良率管理解決方案的全球領先供應商 KLA-Tencor 公司（納斯達克股票代碼：KLAC）推出了 Archer 300 LCM 測量系統。與得到廣泛應用的其前代 Archer 200 相比，Archer 300 LCM 所提供的測量精準度及測量速度大幅改善，且特別具備新的晶粒內測量功能。有了這些創新功能，Archer 300 LCM 能夠用作整個晶圓廠的綜合疊對誤差管理解決方案，滿足檢驗曝光機所需的嚴格規範，並成為緊密控制最先進製程的邏輯電路與記憶體裝置的大量生產機台。此外客戶目前所使用的 Archer 機台也可升級成 Archer 300 LCM。因此 Archer 300 LCM 能帶給先進製程更高效能、並提供低擁有成本疊對測量解決方案。

KLA-Tencor 的疊對測量事業群副總裁兼總經理 Noam Knoll 表示：「實現向 193i 微影的新擴展對關鍵層的疊對容許誤差已產生巨大影響。特別是，兩次圖像合成微影的使用將 32nm 製程上的容許疊對誤差降至僅僅幾奈米，並且之後更先進的製程其容差甚至更小。這種限制是前所未有的。我們新的疊對測量技術機台，Archer 300 LCM，滿足了在兩次圖像合成及其它具有挑戰的層上測量疊對誤差所要求的嚴格規範。我們還開發出一種極具成本效益的方法，讓黃光微影工程師能夠對晶圓進行更多測量，藉此有效監測這些參數：加快測量速度，加上結合使用放在晶粒內的非常微小的測量目標，而非只是放在晶粒切割道間之區域。最重要的是，我們能夠在一個單獨且小巧的機台上提供所有這些功能。我們相信，在解決影響最先進製程疊對難題方面，Archer 300 LCM 向前邁出了一大步。」

Archer 300 LCM 提供多項新功能及特性來協助晶片製造商，以更具有成本效益的方式開發與生產 2Xnm 邏輯電路和 1Xnm 半間距記憶體裝置：

- 光學系統經過進一步改善，能夠提供比上代 Archer 200 更佳的精準度和總體測量不確定度 (TMU)、更好的測量可重複性，以及更快的移動 - 獲取 - 測量 (MAM) 時間；
- 新的晶粒內疊對測量功能有助於晶片製造商實現複雜的疊對校正，以實現精準的圖形曝光成像；並且
- 現有廣泛被使用的 Archer 機台能進行升級，且其設計具備可擴展至其它測量功能的能力，這將有助於保護晶圓廠的資本投資

Archer 300 LCM 系統已出貨至全球主要記憶體和邏輯半導體廠，將用於先進開發和大量生產中的疊對測量應用。為了保持高效能和高產能，業界領先的 Archer 機台由 KLA-Tencor 的全球綜合服務網路提供支援。有關 Archer 300 疊對測量機台的更多資訊，請參觀產品網頁：www.kla-tencor.com/metrology/archer-series.html。

關於 KLA-Tencor：

KLA-Tencor 公司（納斯達克股票代碼：KLAC）是製程控制與良率管理解決方案的領先提供商，它與全球客戶合作，開發先進的檢測與度量技術。這些技術為半導體、資料儲存、LED、光電及其他相關奈米電子產業提供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊，三十餘年來為客戶努力打造優秀的解決方案。KLA-Tencor 的總部設在美國加利福尼亞州 Milpitas，並在全球各地設有專屬的客戶營運與服務中心。如需更多資訊，請參觀網站 www.kla-tencor.com。(KLAC-P)

前瞻性聲明：

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 Archer 300 LCM 的預期效能，半導體產業的未來發展與趨勢及其帶來的預期挑戰，KLA-Tencor 的客戶對 Archer 300 LCM 的預期使用，Archer 300 LCM 機台擴展至其他測量功能的能力，以及 Archer 300 LCM 機台使用者可以實現的預期成本、營運及其他受益等陳述，均為前瞻性聲明，並受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 規定的「安全港」(Safe Harbor) 條款的制約。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，且包含諸多風險與不確定性。由於各種因素，包括延遲採用新技術（無論是由於成本或效能問題抑或其他問題），其他公司推出競爭性產品，或影響 KLA-Tencor 產品的實現、效能或使用的意外技術挑戰或限制，因此實際結果可能與此類聲明中的預計結果實質不同。

###